



2017年12月

Embedded Technology / IoT Technology 事務局

ユニバーシティパビリオン公募のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素より多大なるご支援・ご指導を賜り、誠にありがとうございます。

さて、来年7月に行われる「Embedded Technology West 2018／組込み総合技術展 関西」および「IoT Technology West 2018／IoT 総合技術展 関西」において、下記の通り、大学等研究機関と産業界との連携推進を目的に「ユニバーシティパビリオン」を企画・運営いたします。

研究の成果発表の場のみにとどまらず、本展示会をよりよい産学連携の場としてご利用いただきたく、ご出展希望の場合は、下記記載の出展申込フォームに必要事項をご記入のうえ、下記事務局までお送りください。

皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

記

会 期 : 2018年7月5日(木)、6日(金)

会 場 : グランフロント大阪 (大阪市北区大深町3-1)

参加資格 : 組込み技術およびIoT技術に関する研究、教育、技術移転等を行う大学等研究・教育機関

出展料 : 81,000円(税込)／パッケージブース1小間 ※詳細は次ページのイメージ図をご確認ください)

※展示品の搬出入及び会期中のブース運営は各自で行ってください。

※1団体につき、1小間のご出展とさせていただきます。

展示ブース : 特設パッケージブース1小間(2m×1.5m=約3㎡)

(ブース仕様及び付属備品に関しましては、別紙をご参照ください。

オプション備品(別途有料)もご利用いただけます。)

申込方法 : 以下URLの出展申込フォームよりお申込みください。

<https://etw2018.jcd-ex.net/ja/entry/>

※ユニバーシティパビリオンブースの出展社様には、

共通のパッケージブースをご用意いたします。

通常出展ブースのように、独自の装飾を行うことはできませんので予めご了承ください。

(ポスターの貼付、追加のレンタル備品利用などは可能です。)

申請期限 : **2018年2月28日(水)**

※満小間になり次第、お申込を締め切らせていただく場合がございます。

以上

＜お申込・お問合せ先＞

Embedded Technology / IoT Technology 事務局

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

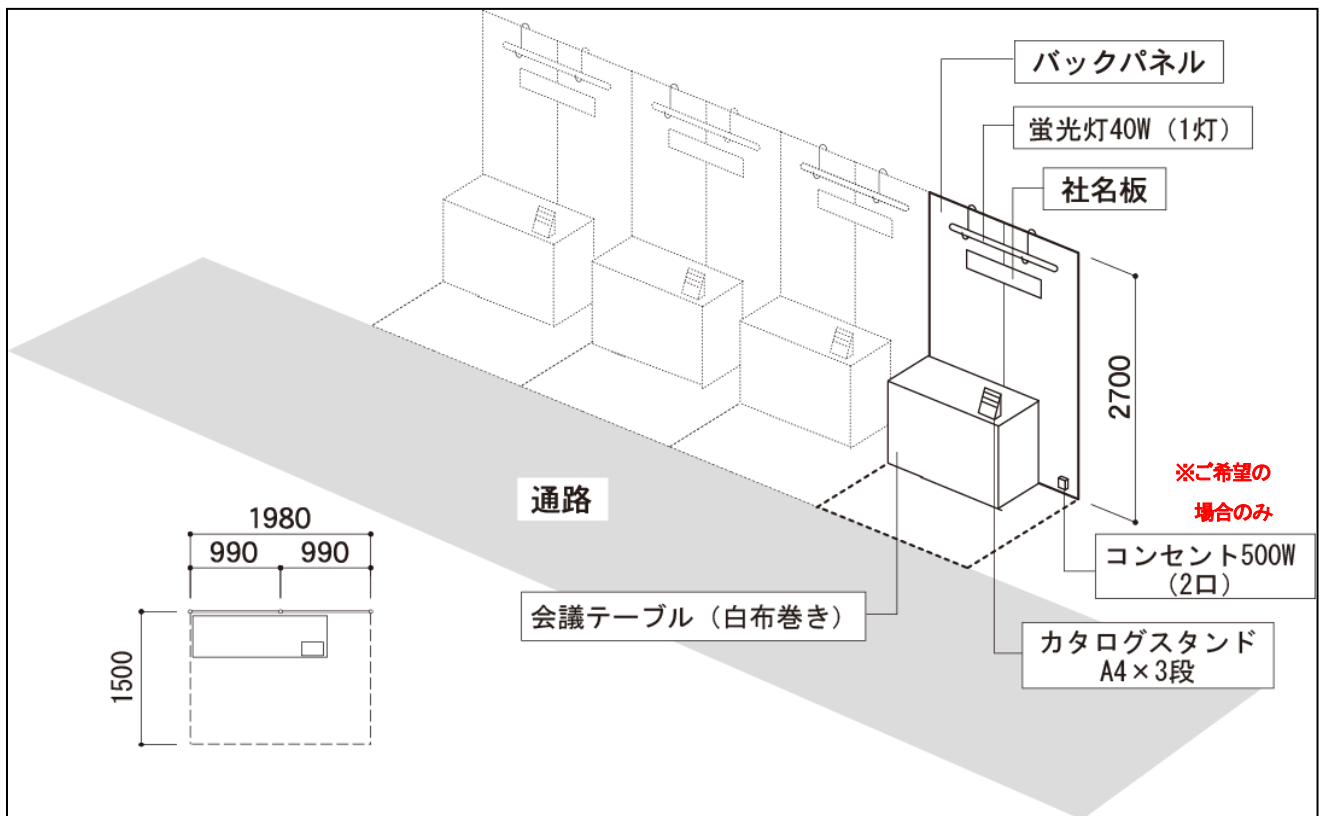
Tel: 03-5657-0756 Fax: 03-5657-0645 Email: etwest@jtbcom.co.jp

公式HP: <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

【ブースイメージ図】

- ・ 形状 : パッケージブース 1 小間 間口 2.0m × 奥行 1.5m × 高さ 2.7m
- ・ 仕様 : システムパネル使用 (W2.0m × H2.7m / バックパネルのみ)
学校・研究室名板 (W90cm × H20cm ゴシック統一書体) 1 枚
会議テーブル (W150cm × D60cm × H73cm / 白布巻き) 1 台
卓上カタログスタンド (A4 サイズ × 3 段) 1 台
蛍光灯 (40W) 1 灯
コンセント (500W までの電源工事及びその電気使用料) 2 口
**※コンセントの設置をご希望の場合は、
出展申請書の該当欄にて「要」に丸をお付けください。
「不要」をお選びいただいた場合は、設置いたしませんので、ご注意ください。**

【ユニバーシティパビリオン イメージ図】



【申込方法】

以下 URL の出展申込フォームに必要事項をご入力の上、お申込みください。

<URL> <https://etw2018jcd-ex.net/ja/entry/>

<申込期限> **2018年2月28日(水)**